

液状透明封止樹脂

HL2002(A)/ HL2002(B)

1. 特徴

HL2002 は、2液性熱硬化タイプの透明エポキシ樹脂です。

主に SMD 用の光半導体の封止材として、PLCC との接着力、耐リフロー性、耐黄変性に優れた特性を有しており、白色、青色、フルカラーの SMD 用封止材として長年の信頼性と実績を有しております。L/F との優れた密着性を生かし FluxLED(ピラニア)の封止材としてもご使用頂いております。

2. 樹脂特性

特性項目	単位	主剤 HL2002(A)	硬化剤 HL2002(B)
主成分組成		エポキシ樹脂	酸無水物
色相		無色～淡黄色	無色～淡黄色
推奨混合比	重量比	100	95
比重(25℃)		1. 17	
粘度(25℃)	mPa・s	2,800±500	140±40
		600±100	
ゲルタイム(121℃)	分	7. 0±3. 0	

【注】 上記は代表値であり 規格値ではありません。

3. 硬化物樹脂特性

特性項目	単位	特性値	備考	
推奨硬化条件		SMD : 135°Cx1hr + 150°Cx4hrs FluxLED: 115°Cx2hrs + 150°Cx4hrs		
ガラス転移温度	°C	130	TMA	
線膨張率	<Tg	ppm/°C	70	40°C~80°C
	>Tg		180	180°C~210°C
曲げ強度	N/mm ²	158	JIS K6911	
曲げ弾性率	N/mm ²	3,300	JIS K6911	
硬度		89	Shore D	
屈折率		1.54	アッペ	
煮沸吸水率	Wt%	0.41	100°C/1hr	

【注】上記は代表値であり 規格値ではありません。

4. 使用上の注意

冷暗所にて保管して下さい。

主剤・硬化剤共に、皮膚に触れると炎症やアレルギーを起こす事がありますので、注意してください。もし、触れた場合は、石鹼で十分に洗ってください。また換気を十分に行ってください。詳細な作業・安全上の注意事項につきましては MSDS (Material Safety Data Sheet) をご参照ください。

稲畑産業(株)情報画像本部 FPD-II オプトチーム

東京都中央区日本橋本町2-8-2

Tel:03-3639-6616 Fax:03-3639-6782